20

CLIPPEDIMAGE= JP363290271A

PAT-NO: JP363290271A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63290271 A

TITLE: SHUTTER FOR TARGET PART OF SPUTTERING DEVICE

PUBN-DATE: November 28, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ODA, YOSHIO

MORI, YOSHIAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

SEIKO EPSON CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP62123509

APPL-DATE: May 20, 1987

INT-CL (IPC): C23C014/34

US-CL-CURRENT: 204/298.11,204/298.26

ABSTRACT:

PURPOSE: To form a desired film on a substrate and to prevent contamination of targets by rotating the shutter of a target part which has an aperture part and shielding part and is used in a sputtering device around the concentrical axis above the plural targets and moving the shutter vertically between the targets and the substrate.

CONSTITUTION: The plural targets 2a, 2b are concentrically disposed to face the substrate 6 to be treated in a vacuum chamber 1. The disk-shaped shutter 3 of the target part having the aperture part 3a and the shielding part 3b is concentrically rotated by its driving shaft 4 relative to the plural targets and is moved vertically between the substrate 6 and the targets by the shaft 4. Only the target 2a adheres to the substrate 6 when the aperture part of the shutter 3 comes over the target 2a on movement of the shutter near to the targets. A high-frequency induction discharge hardly arises in the target 2b, since the spacing from the shutter 3 is small. The consumption of the target 2b is thus prevented. The contaminating material on the target surface is adhered to the shutter 3 by rising the shutter 3 to the substrate 6 side. The target surface is thereby cleaned.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

SHUTTER

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-290271

⊕Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)11月28日

C 23 C 14/34

8520-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

劉発明の名称 スパツタ装置のターゲット部シャッタ

到特 願 昭62-123509

②出 願 昭62(1987)5月20日

⑫発 明 者 織 田 吉 夫 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

会社内

①出 願 人 セイコーエプソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

⑩代理人 弁理士最上 務 外1名

明 和 书

1. 范明の名称

スパック装置のターゲット部シャック

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本弱明はスパッタ装置のターゲット部シャッタに関する。

(従来の技術)

従来、スパック装置のシャッタとしては、 第 3 図に示すように関口部 3 a と 遊 蔽部 3 b とを持ち (発明が解決しようとする問題点)

しかし従来のシャッタの場合、複数のシャッタを必要とするために駆動機構およびシール機構がな雑になるという問題点があった。また技術がシャッタが活動であるいは多数の基板に理験を付けることが困難であった。そこで本発明は従来のこのような問題をおめいは多数の基板の設置が可能なターゲット部シャッタの提供を目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本苑明によるスパッタ設置のターゲット部シャ ッタは複数のターゲットが同心円状に設置された ターゲットホルダーと、これに対向した猛板とか らなるスパッタ装置において、関口部と遮蔽部と を持ち、前記ターゲットホルダと同心の駆動額ま わりに回転しかつ招動し得ることを特徴とする。 ((* M)

上記のような本苑明の構成によれば、 単一の クーゲット邱シャックをターゲット寄りに移動さ せて回転させることにより、猛板に付着させたい 物質ターゲットの選択が可能となり、シャッタを 猛仮寄りに移動させてターゲットを遮蔽するよう に回転させることにより、ターゲット表面の汚染 物質の除去が可能となる。

(実施例)

第 1 図および第 2 図に本発明の実施例の断面図 を示す。 茲板6および猛板ホルダ7に対向した クーゲットホルグ5には複数のターゲット2a、 2bが同心円状に設置されている。関口部3aぉ

3に付着させて除去させることが可能となる。さ らにグーゲット2a、2bを塩蔵してシャッタ3 をクーゲット2a、2b側に近づけることにより 逆スペッタ(スパッタエッチ)時の不純物がター **ゲット2a、2bに付借することも妨げる。** (発明の効果)

本発明は以上説明したように、猛板に付着させ たい物質のターゲットの選択および、ターゲット 表面の汚染物質除去が、単一のターゲット館シャ ックの回転および招助のみにより行なえるため構 造が個単となる。しから基板部シャックの趨動す る氽地が不用となるため、大面積あるいは多数の 拡板の設置を可能とする効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明によるスパック装置において、 ターグット部シャッタがターグット寄りに移動し た時を示す断面図、第2回は本発明によるスパッ タ設置においてターゲット部シャッタが猛板寄り に移動した時の断面図、第3図は従来のスパッタ

よび、 遊 版部 3 b を持つターゲット 郎シャック 3 は、ターゲットホルグ5と同心軸上で回転しかつ 招動し得るクーゲット部シャッタ駆動軸4に固定 されている。

昨1日は、ターゲット部シャッタ3がターゲッ ト寄りに移動した時の断面図である。ターゲット 2agに、ターゲット部シャッタ明口部3aがあ り、ターゲット2aがスパッタされて猛坂6に付 むする。この時クーゲット部シャッタ遮蔽部3 b はターゲット2b倒にあるが、ターゲット2bと シャック3の距離を十分小さくすることにより高 周波の誘導放電が起こりにくくなり、ターゲット 2 b の消耗が防止され、加えてクーゲット 2 a か らのスパッタ粒子のまわりこみも少なくなる。

またターケット2aを交換した時などには、策 2 図のようにターゲット部シャック 3 を延仮 6 寄 りに移動させることにより、放電を起こしやすく し、さらにクーケット邸シャッタ3を回転させて ターゲット2a、2bを遮蔽してスパッタするこ とにより、ターケット表面の汚染物質をシャッタ

装置の断面図である。

- 1 ... チャンパ
- 2 a 、 2 b … ターゲット
- 3 … ターゲット 怒シャッタ
- 3a…クーケット部シャック同口部
- 3 b … ターケット部シャッタ 遮蔽部
- 4 … ターゲット部シャッタ駆動軸
- 5 … ターゲットホルダ
- 6 … 孫板
- 7…茄板ホルグ
- 8 … 猛板部シャッタ
- 9 … 基板郎シャック駆動軸

出願人 セイコーエブソン株式会社 弁理士 最 上 代理人



